

<b>LAGENAUFBAU HDI (Standard)</b>		<b>10 - Lagen</b> Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm	
HDI10_1+8+1_1,20_35		<b>1 + 8 + 1</b>	
<b>WE-Artikel Nr.:</b>			

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE					[µm]	[µm]	
1	TOP/VS		Folie	12 µm <sup>1)</sup>	1 x 1080	12		
						60		
2	2				35 µm		33	
				0,100 mm			100	
3	3				35 µm		33	
						2 x 1080	124	
4	4				35 µm		33	
				0,100 mm			100	
5	5				35 µm		33	
						2 x 1080	124	
6	6			35 µm		33		
			0,100 mm			100		
7	7			35 µm		33		
					2 x 1080	124		
8	8			35 µm		33		
			0,100 mm			100		
9	9			35 µm		33		
					1 x 1080	60		
10	BOT/RS		Folie	12 µm <sup>1)</sup>		12		

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1180

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

<b>MATERIALDICKE:</b> <b>1,20</b>	+/-	0,10	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,29	+/-	0,13	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,35	+/-	0,15	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		
Erstellt am 27.03.2006	von S. Keller	Geprüft am 04.05.2006	von M.Kress	Freigegeben am 04.05.2006	von R. Schönholz	Revision 00	Seite: 3+